

扬州YXLON依科视朗 Xray 圣全

产品名称	扬州YXLON依科视朗 Xray 圣全
公司名称	苏州圣全自动化设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市工业园区亭翔街3号
联系电话	13812633160 13812633160

产品详情

6. X射线成像技术在BGA焊接质量检测中的应用

BGA（球栅阵列封装）是一种典型的高密度封装技术，其特点是芯片引脚以球形焊点按阵列形式分布在封装下面，可使器件更小、引脚数更多、引脚间距更大、成品组装率更高和电性能更优良。

目前BGA焊接质量检测手段非常局限，常用的检测手段包括：目检、飞针电子测试、X射线检测、染色检测和切片检测。其中染色和切片检测为破坏性检测，可作为失效分析手段，不适于焊接质量检测。无损检测中目检仅能检测器件边缘的焊球，YXLON依科视朗 Xray，不能检测焊球内部缺陷；飞针电子测试误判率太高；而X射线检测利用X射线透射特性，可以很好地检测隐藏在器件下方的焊球焊接情况，是目前很有效的BGA焊接质量检测方法。

AOI 检测设备市场在国内处于刚起步阶段，目前市场上只有20%-30%的SMT 生产线装配了AOI 检测设备，而国际领先电子制造企业的SMT 生产线基本都配置了AOI 检测设备。即便目前配备了AOI 检测设备的电子制造企业绝大多数也只在炉后配备一台进行全检，而按照国际经验，每条生产线至少要配置三台AOI 检测设备放置在生产线不同测试工位。因此随着行业的发展及AOI 检测设备自身具备的优势，未来AOI 检测设备的装备率会越来越高。

通过减小ICT/AXI多余的测试覆盖面可大大减小ICT的接点数量。这种简化的ICT测试只需原来测试接点数的30%就可以保持高测试覆盖范围，而减少ICT测试接点数可缩短ICT测试时间、加快ICT编程并降低ICT夹具和编程费用。在过去的两三年里，采用组合测试技术，特别是AXI/ICT组合测试复杂线路板的情况出现了惊人的增长，而且增长速度还在加快，因为有更多的生产厂家意识到了这项技术的优点并将其投入使用。

扬州YXLON依科视朗 Xray-圣全由苏州圣全科技有限公司提供。苏州圣全科技有限公司是江苏 苏州 ,工业

自动控制系统及装备的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在圣全自动化设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创圣全自动化设备更加美好的未来。